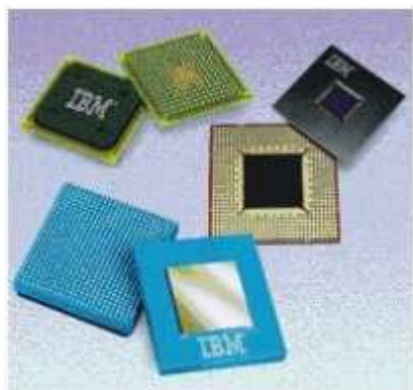


RTC-08 Montaż, demontaż i regeneracja wyprowadzeń komponentów BGA/CSP



MONTAŻ, DEMONTAŻ I REGENERACJA WYPROWADZEŃ KOMPONENTÓW BGA/CSP

CEL SZKOLENIA:

- Zdobyć wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie montażu i demontażu elementów BGA/CSP, a także zapoznanie się z metodami regeneracji wyprowadzeń oraz kontroli jakości połączeń komponentów. Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowiązujący standard IPC-7711 i IPC-7095.

CHARAKTERYSTYKA

Liczba godzin: 24

PROGRAM SZKOLENIA

- BHP na stanowisku pracy
- Zabezpieczenia przed ESD
- Typy i rodzaje obudów komponentów BGA/CSP
- Montaż i demontaż z użyciem systemów pozycjonowania optycznego zgodnie z IPC-7711
- Sposoby inspekcji i właściwej interpretacji dokumentacji rentgenowskiej zgodnie z IPC-7095
- Techniki regeneracji wyprowadzeń w komponentach BGA/CSP
- Zajęcia praktyczne
- Egzamin teoretyczno-praktyczny

SZKOLENIE PRZEZNACZONE JEST DLA OSÓB

- Bezpośrednio zajmujących się montażem i demontażem komponentów BGA/CSP z uwzględnieniem kontroli jakości montażu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

- Pozyskają najnowszą wiedzę na temat montażu i demontażu komponentów BGA/CSP i stosowanych sposobów inspekcji po montażu, z uwzględnieniem obowiązujących międzynarodowych standardów
- Uzyskają imienny certyfikat ukończenia szkolenia
- Uzyskają imienny certyfikat MEN

REFUNDACJA

Istnieje szereg programów pomocowych skierowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Istotne korzyści występują zwłaszcza w przypadku zatrudniania nowych pracowników:

- bezpłatne szkolenie dla osób nowozatrudnianych bezrobotnych
- personel przygotowany do pracy z zachowaniem wysokich standardów jakościowych już od pierwszego dnia pracy
- brak okresu przejściowego, który zwykle potrzebny jest nowym pracownikom, aby zaaklimatyzowali się w nowym miejscu pracy.

W przypadku zdecydowania się na udział w jednym z organizowanych przez RENEX szkoleń firma pomaga w uzyskaniu refundacji.